

产品简介

SUITIT[®] 双泰 单组分环氧胶 ST7003 是加热固化环氧树脂胶粘剂。本品可在 75℃ 快速固化，低收缩率，高粘接强度，优良的导电性和导热性，对许多材料有很好的粘接性。

典型用途

主要用于摄像模组 CCD/CMOS 边框的粘接，适用于对温度敏感的组件的粘接。

固化前特性

	典型值	范围	测试标准
外观	灰色液体		
基料化学成分	环氧树脂		
粘度 (mPa.s) (Brookfield DV2T) 52#转子		10000-30000	GB/T 2794-1995 13354-199
密度 (g/cm ³)	2.92	2.80-3.20	GB/T 2
室温使用期 (天@25℃)	3		

推荐固化条件

在 75℃ 固化 20min

在 80℃ 固化 15min

胶水在受热的状态下会加快反应并固化，固化的速度和强度取决于加热的温度和时间，温度越高固化所需要的时间越短。要根据加热设备的加热效率和被粘接材料适当的调节加热的温度和时间，以得到最佳的工艺参数。

固化后特性

(试样在 80℃ 固化 20 分钟)

物理特性	典型值	测试标准
硬度 (邵氏 D)	72	GB/T 2411-1980
剪切强度 (MPa)	18	GB/T 7124-1986
断裂伸长率 (%)	4.0	GB 1040-1992
玻璃转化温度 (℃) (DSC)	30	GB 19466.2-2004
热膨胀系数		GB/T 1036-1989

烟台泽邦化工有限公司

山东省烟台市芝罘区幸福十二村东街 118 号

电话: 0535-6870159 传真: 0535-6841872 www.thebond.cn

servi ce. chi na@thebond. cn提供技术支持

THEBOND

ST7003 技术资料

低温固化胶

2017.05

α 1 (PPM/°C)	43	
α 2 (PPM/°C)	136	
吸水率 (%) (24h@25°C)	0.16	GB/T 1034-1998
体积电阻 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	<5	GB/T 1410-2006
导热系数 W/(m • K)	>3	ASTM-D5470

使用说明

在使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开铝箔包装(建议回温时间至少 4 小时)。胶水对湿度敏感，请不要将胶水长时间暴露在空气中，建议使用环境相对湿度低于 60%，回温次数不超过三次。

本品在 25°C，相对湿度<60%的条件下，使用期是 3 天。

未用完的胶，请先放入塑料袋内密封后再放入冰箱贮存。

注意事项

请远离儿童存放。

本品建议在通风良好的场所内使用。

若不慎沾到皮肤上，请马上用肥皂水清洗。

若不慎沾到眼睛上，请先用大量的水清洗，然后就医。

详细内容请参阅本品的 MSDS。

包装

10ml/支

贮存

产品密封，在-40°C 洁净、干燥处贮存。

贮存期：六个月。

烟台泽邦化工有限公司

山东省烟台市芝罘区幸福十二村东街 118 号

电话：0535-6870159 传真：0535-6841872 www.thebond.cn

servi ce. chi na@thebond. cn提供技术支持

THEBOND